

Im Rahmen des 3. Industrie-Partner-Symposiums (IPS) der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik fand am 30.10.2010 ein Kolloquium des IAVT und des ZµP statt. Zugleich war dies das 55. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI).

Agenda

Vorträge

Erste Ergebnisse zur 3D-Integration aus der Nachwuchsforschergruppe

Prof. Klaus-Jürgen Wolter, IAVT

Future Challenges in Assembly and Packaging

Dr. Jürgen Grafe, Fraunhofer IZM-ASSID

Through Silicon Vias für die 3D-Integration - Untersuchungsmethoden für Fehleranalyse und Prozesskontrolle

Dr. Rüdiger Rosenkranz, Fraunhofer IZFP-D

Charakterisierung der viskoelastischen Eigenschaften polymerer Werkstoffe der Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Björn Böhme, IAVT

Postervorträge

Solder Joints under Harsh Mechanical Loading

Karsten Meier, IAVT

Inductive Excited Thermography for Electronic Assemblies

Johannes Bohm, IAVT

Self-Alignment for 3D-Packaging

Max Frömmig, IAVT

Development of a Thin Nanowire Polymer Composite Film with Anisotropic Electrical Conductivity

Matthias Graf, IAVT

Modeling of Manufacturing Processes for 3D Systems

Jan Lange, IAVT

Interconnect Technology for Three-Dimensional Chip Integration using Solid-Liquid Interdiffusion Bonding

Iuliana Panchenko, IAVT

Thermo-mechanical Behavior of Dies containing Through-Silicon-Vias

Peter Sättler, IAVT

Future Perspectives of Carbon Nanotubes for TSV Interconnect Applications

Lavanya Aryasomayajula, IAVT

Dresdner Fraunhofer-Cluster Nanoelektronik

Dr. René Hübner, IZFP-D

In situ-ATR-FTIR-Untersuchungen zur Wirkungsweise von Additiven in TSV-Cu-Elektrolyten

Dr. Ulrich Künzelmann, IHM